

平成14年度事業計画書

自:平成14年4月 至:平成15年3月

1. 国際会議・学術講演大会・展示会等の開催(定款第4条第1号関係)

- (1)IEEE CPMT Japan Chapter と共催で、第6回目の国際会議「2002 ICEP (旧 IEMT/IMC Symposium)」(2002.4.17~19, 於: 第一ホテル東京シーフォート)開催(次回予定:2003.4.16~18)
- (2)第16回マイクロエレクトロニクスショー(2002.4.17~19, 於:東京流通センターE・Fホール)は「最先端実装技術・パッケージ展」を前面に開催(次回予定:2003.4.16~18)
- (3)「第17回エレクトロニクス実装学術講演大会」(2003.3.12~14, 於:東京電機大学)開催
- (4)先端技術セミナーの開催
 - ・定例セミナー(2002.7, 2002.11, 2003.1の3回を予定)
- (5)「第12回マイクロエレクトロニクスシンポジウム」(2002.10.8~9, 於:大阪大学コンベンションセンター)開催
- (6)地域交流の促進

2. 調査・研究活動(定款第4条第2号関係)

- (1)ワークショップの開催
 - ・ワークショップ2002(2002.9.5~6)
 - ・関西ワークショップ2002(2002.11.29)
- (2)技術運営委員会とその下にある13分野の技術委員会(材料/回路・実装設計/電磁特性/配線板製造/信頼性解析/装置/電子部品・実装/検査/光回路実装/環境調和型実装/半導体パッケージ/マイクロメカニクス実装/電子SI)において、実装技術に関する技術的な諸課題と今後の動向を調査研究するため、研究討論会、ワークショップ、シンポジウム等を開催。
- (3)エレクトロニクス実装技術の分析・調査
- (4)低温鉛フリーはんだ実装技術開発プロジェクトの推進

3. 普及啓発活動(定款第4条第3号関係)

学会賞の授与、技術講習会・入門講座・技能検定試験講習会等の教育事業活動の充実。

- (1)「エレクトロニクス実装学会賞」等の授与
- (2)「エレクトロニクス実装技術総合講座」
- (3)「実装技術入門講座」
- (4)「プリント配線板製造技術講座(入門編&中級編)」
- (5)「技能検定設計実技講習会」

4. 情報収集及び提供活動(定款第4条第4号関係)

- (1)「エレクトロニクス実装学会誌」の発行
 - 会員の日常の技術・研究活動の成果として発表される研究論文、技術論文、速報論文、解説等を学会誌に掲載し、エレクトロニクス実装の技術と研究に関する最新の情報を収集・提供する。
- (2)「プリント配線板技能検定受検者用テキスト」の発行
- (3)各種技術委員会・研究会の成果のテキスト発行
- (4)海外関係団体出版物の頒布、海外情報の提供

- 5 . 内外機関等との交流・協力活動(定款第 4 条第 5 号関係)
 - (1) IMAPS との連携発展
 - (2) 海外の国際会議の開催に協力・会員の参加への支援
 - (3) 日韓共同実装技術セミナー開催
 - (4) アジア連絡会との連携
 - (5) 電子 SI 連絡協議会との連携
- 6 . その他
 - ・ 広報活動の積極化 , および会員増強運動の強化